**Neue Produkt Ankündigung**

11. März 2016   
Fuji Machine Mfg. Co., Ltd.

**Einführung der Fuji "AIMEX III" zur Erweiterung der Bestück Plattform in Flexibilität**

In Bezug auf die Bestück-Prozesse, die für elektronische Leiterplatten verwendet werden, gibt es fortwährend wachsende Anforderungen nach High-Mix Produktion wie auch immer mehr nach Variable-Mix und Variable Volumen Produktion, um mit ständigen Veränderungen auf dem Markt mithalten zu können.

Damit Sie als Kunde diese Anforderungen erfüllen können, entwickelte Fuji die flexible und erweiterbare AIMEX IIIc, die im Oktober 2015 veröffentlicht und seither mit Erfolg in den Markt gebracht wurde. Auf diesen großen Erfolg aufbauend, möchten wir Ihnen die zusätzliche Version, AIMEX III verkünden. Eine Maschine basierend auf den gleichen gelungenen Konzepten wie die AIMEX IIIc, plus dem Vorteil für Sie, große Leiterplatten mühelos zu bestücken.

**Produkt Spezifikationen**

1. Optimal für High-Mix-Produktion  
   Die Branchen-Spitzenklasse verarbeitet bis zu 130 verschiedenen Bauteile auf einer Maschine. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die AIMEX III in Kombination mit den Hexa-Feedern eine Steigerung der Feeder Kapazität um weitere 50%, damit Sie flexibel auf Variationen in der zu verarbeitenden Bauteilmenge reagieren können. Zudem gestattet Ihnen der Einsatz des DynaHead (DX) mit seinen zwei Revolvern und dem Greifer – mit nur einer Maschine – das komplette Bauteilspektrum von kleinen 0402\* (01005 ") Bauteilen bis großen 74 x 74 mm Bauteilen zu bestücken.  
   \*0402 (01005 ") elektronische Bauelemente sind 0,4 x 0,2 mm groß.
2. Ihre Lösung für Variable-Mix, variable Volumenproduktion   
   Diese Maschine kann mit einer Koplanaritäts-Check-Einheit ausgestattet werden, die Mängel an Bauteilen vor der Platzierung erkennt. Eine LCR-Check-Einheit zur Messung und Überprüfung von Bauteileigenschaften ist ebenfalls enthalten. Dies ermöglicht es Ihnen, die Qualität im Produktionsprozess auch für variablen Volumen mit variabler Mix-Produktion sicher zu gewährleisten.
3. Unterstützt große Leiterplatten (PCB)  
   Leiterplatten bis zu 774 x 710 mm können bestückt werden. Eine Double-Spur-Konfiguration ermöglicht es Ihnen, viele verschiedene Leiterplattentypen und unterschiedliche Programme und Produktionsweisen für die Bestückung zu verwenden.
4. Easy-to-use, On-Maschine Bearbeitungsfunktion an der AIMEX III  
   Ein 12-Zoll-Touch-Screens erleichtert Ihnen die Bedienung an der Maschine.  
   Hochleistungs-Fertigung für neue Produkte und Prototypen sowie eventuelle Rückmeldungen von Fehlern können von Ihnen jetzt schneller als je zuvor mit On-Machine Bearbeitung behandelt werden.
5. Verbesserte Produktivität  
   Der H24G High-Speed-Kopf bringt die Maschine performancemäßig auf die Überholspur. Mit einer Bestück-Rate von 37.000 BE/h im Geschwindigkeits-Modus, bei einer gleichzeitigen Genauigkeit von ± 38 µm garantiert Ihnen die AIMEXIII Spitzenklasse für Ihre Fertigung.  
   BE/h\*: Bauteile pro Stunde, mögliche Bestück-Menge pro Stunde.

